Opravárske pracovisko BGA Hakko FR-811 zostava M s 2-3 bodovým optický

Obj. číslo:	102004045
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

Profesionálne opravárske pracovisko určené na rework BGA a ďalších komponentov. Zostava obsahuje teplovzdušnú stanicu HAKKO FR-811, spodný predohrev C5023, držiak na DPS C5027 a stojan na teplovzdušnú stanicu C5029.

Video

https://www.abetec.sk/sk/eshop/product/opravarske-pracovisko-bga-hakko-fr-811-zostava-m-s-2-3-bodovym-optickym-centrovani

Obsah balenia

FR-811 SMD opravárenská stanica.

CD so softvérom a ovládačom (kompatibilné iba s Windows 7).

Držiak C5033.

Vákuová pipeta B3023.

USB kábel.

Termočlánok.

Tepelne odolná doska.

Napájací kábel.

Vákuové násadky, priemer 3, 5, 7 mm (2 ks od každej veľkosti).

Držiak na DPS C5027.

Stojan na teplovzdušnú stanicu C5029.

Spodný predohrev C5023.

Manuál.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Napájanie	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Príkon	1200 W
Rozsah teplôt (minimálny)	50 °C
Rozsah teplôt (maximálny)	600 °C
Teplotný profil	ano

Odporúčaná max. veľkosť DPS	248 x 140 mm
Opakovateľnosť procesu	zdokumentovaná, řízená
Stlačený vzduch	max. 115 l/min
ESD prevedenie	ano
Obsah balenia	horkovzdušná stanice HAKKO FR-811, spodní předehřev C5023, držák na DPS C5027, stojan C5029
Typ spodného predohrevu	hybridní
Typ horného ohrevu	horký vzduch/plyn
Určené na opravy	mobilní telefony, tablet, laptop, herní konzole, Wii, Xbox, PC základní desky, průmyslové, náročné vícevrstvé DPS
Veľkosť ohrevnej plochy	190 x 80 mm
Výkon spodného predohrevu	730 W
Optická kontrola procesu	vision (kamera)
Software	monitorovací software, profilovací software
Proces opravy	plně ruční oprava
Procesná kamera	ano
Opravované súčiastky	SMD, SO, SOIC, QFP, PLCC, BGA, reballing BGA , vývodové součástky
Výrobca	Hakko